



散热桥技术

用于输入/输出 (I/O) 应用

散热桥技术是 TE Connectivity (TE) 最新开发的创新型散热技术，与传统的散热技术（如间隙垫或散热垫）相比，热阻性能提升 2 倍。这一解决方案的适时推出，旨在满足客户由于功率要求日益增长而需要更多散热方式的需求，特别是气流受限的应用、液体冷却或冷板应用。

散热桥技术相比市场上同类散热解决方案具有更出色的散热性能，此外还提供更高的可靠性，而这要归功于其可防止该产品日渐产生凝固和松弛的弹性压缩设计。其有助于确保性能的一致性和持久性，减少维修期间更换部件的情况。

应用

- 高性能计算 (HPC)
- 以太网交换机
- 5G/无线
- 服务器
- 以太网SP路由
- 芯片组冷却

主要优势

- 热阻性能提升 2 倍
- 更加可靠，更加耐用
- 更加易于维护

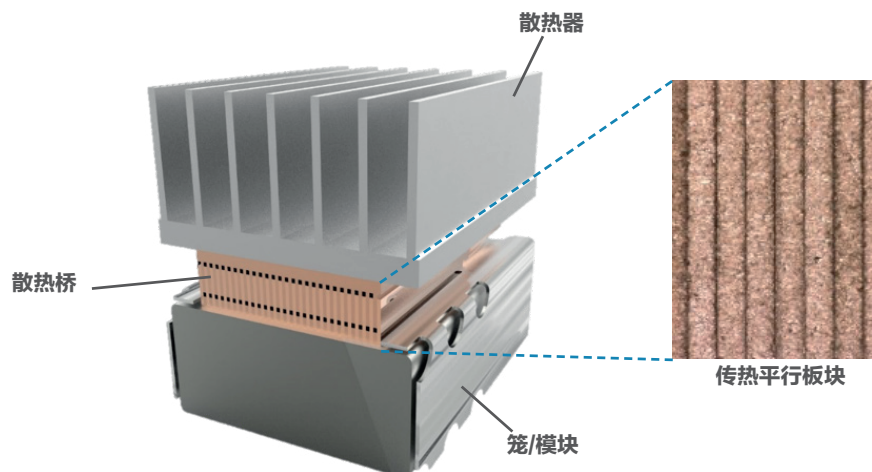
产品手册

- 文件编号: [108-130042](#)

散热桥技术

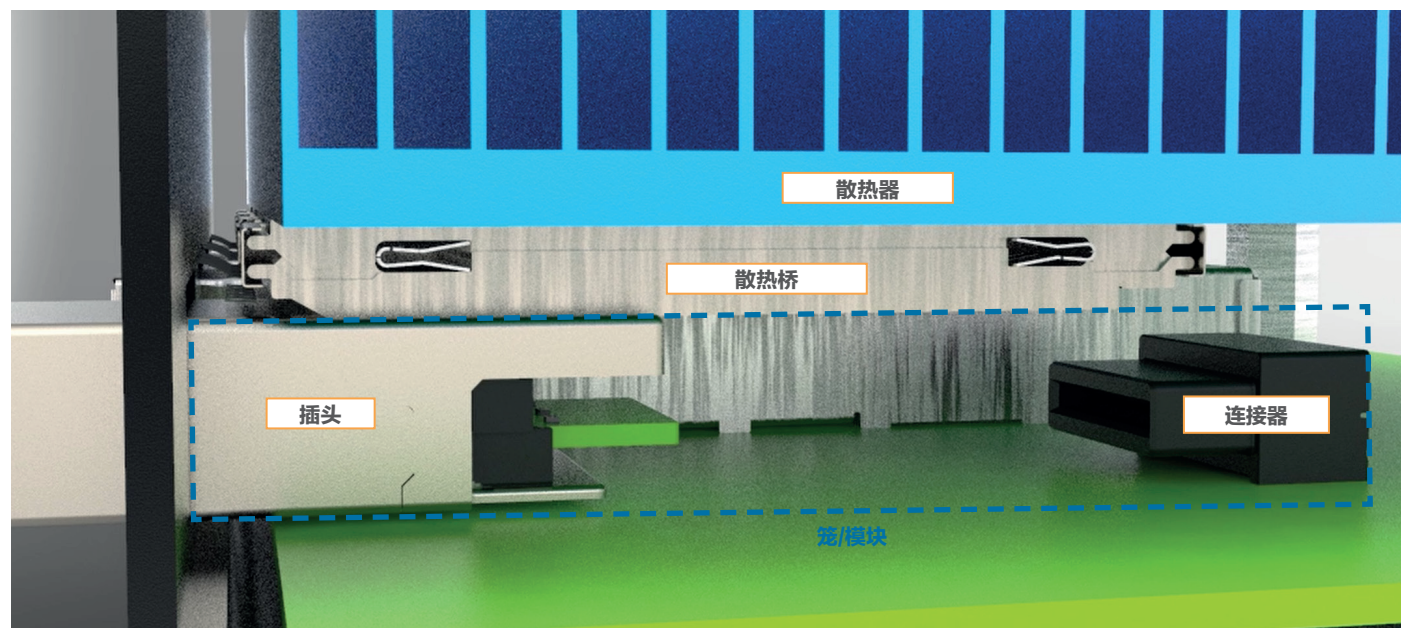
散热桥的工作原理

- 一系列高度平行的板块交错排列，使热量从I/O模块传递到冷却区
- 集成的机械弹簧提供接口力和1.0毫米的压缩行程
- 板块间隙近乎为零，增强了可压缩性和热传导性能
- 预先装配在I/O笼上
- 接口可加油脂（可选）



技术特点和优势

- 弹簧桥提供1.0毫米（典型值）的 Z 轴压缩行程
- 独立的板块驱动支持在 X 轴上实现表面保形性
- 双弹簧设计允许在 Y 轴上实现倾斜适应性
- 如果每个板块有 3 个触点，则一个典型的散热桥将有 150 多个接触点与相邻表面接触
- 干接口阻力比大多数传统型骑式散热器低 20-40%



散热桥技术

带散热桥的笼式组件

TE 产品料号	形状系数	配置	图片
2358986-1	SFP+	1x1	
2354751-1	QSFP-DD	1x1	
2359309-1	QSFP28	1x1	
2354935-1	QSFP28	1x4	
2355519-1	QSFP28	1x6	

如需了解定制设计方案，请联系TE。

te.com/thermalbridge

TE Connectivity、TE Connectivity (标识) 和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。本文中的所有其它标识、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

TE 已尽力确保本产品手册中信息的准确性，但并不保证本文不会出现任何纰漏，针对信息的准确性、正确性、可靠性及可用性亦未做任何其他陈述或担保。对本文所涉及的信息，TE 保留进行更改的权利，恕不另行通知。对本产品目录所述信息，包括但不限于适销性担保或特殊用途的适用性，TE 明确声明不做任何隐含担保。产品目录中的尺寸仅供参考，如有变化恕不另行通知。如规格发生变更，恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 TE。

© 2023 TE Connectivity 版权所有。

03/23